

证券简称：艾为电子

证券代码：688798

上海艾为电子技术股份有限公司

投资者关系活动汇总表

(2024年4月16日-18日)

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	中信建投、人保资产、民生证券、国寿安保、国君资管、中银证券、嘉合基金
时间	2024年4月16日、2024年4月17日、2024年4月18日
地点	公司会议室、通讯方式
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：余美伊
投资者关系活动主要内容介绍	<p>第一部分：解读公司2023年年度报告并介绍公司概况、公司成长、公司团队、主要产品线等。</p> <p>第二部分：问答环节：</p> <p>问题一：请问公司2023年度营收增长的因素有哪些？</p> <p>回答：公司持续丰富和优化产品品类和结构并推出更多新产品，逐渐从占有相对份额的手机、AIOT领域扩展到工业、汽车等领域，不断开拓市场领域和客户群体，同时也在推进工业和汽车领域的研发进展。公司根据客户需求及时进行技术和产品创新，加快产品迭代以及产品性能和成本优化，最终实现营业收入创历史新高。</p> <p>问题二：2023年度公司在高性能数模混合产品线上有哪些突破？</p> <p>回答：公司采用先进工艺，持续进行产品创新，打造高性能模拟功放和内嵌丰富音效算法的DSP数字功放；不断升级神仙算法，实现以算法、硬件、系统解决方案三位一体的立体式发展。首款数字中功率功放产品实现行业头部客户导入验证，发布量产应用于车载T-BOX的音频功放芯片，awinicSKTune®神仙算法首次实现销售。报告期内，公司发布了Boost升压、免电感升压、电池直通等Haptic</p>

系列的升级产品，压感检测处理器通过 AEC-Q100 认证，awinicTikTap® 4D 触觉 Engine 软硬件一体方案获得品牌客户认可并实现量产。公司在国内首先突破手机摄像头光学防抖 OIS 技术实现规模量产，并已规划了 AF 和 OIS 全系列产品，包括开环单端驱动，低功耗开环中置驱动，集成霍尔传感器的闭环驱动，OIS 驱动等产品。VCM 驱动芯片已实现业绩大幅增长，SMA 驱动芯片成功导入品牌客户实现量产出货。

问题三：请问公司目前有哪些主要客户？

回答：公司产品以新智能硬件为应用核心，通过突出的研发能力、可靠的产品质量和细致的客户服务，覆盖了包括小米、OPPO、vivo、传音、TCL、联想、比亚迪、现代、五菱、吉利、奇瑞、零跑、微软、Samsung、Meta、Amazon、Google 等众多品牌客户。以及华勤、闻泰科技、龙旗科技等知名 ODM 厂商；在可穿戴设备、智能便携设备和 AIoT、工业、汽车等细分领域，持续拓展了细分领域的头部客户。

问题四：请问公司目前的产品线布局是怎么样的，料号数量有多少？

回答：公司产品主要应用于消费电子、AIoT、工业、汽车领域，通过多年的积累，公司拥有丰富且齐全的产品系列，公司产品在技术领域覆盖高性能数模混合芯片、电源管理芯片、信号链芯片，截至 2023 年底，产品型号达到 1,200 余款。公司开发的音频功放芯片、背光驱动、呼吸灯驱动、闪光灯驱动、过压保护、GNSS 低噪声放大器、FM 低噪声放大器、马达驱动等各类产品在消费电子、AIoT、工业、汽车的市场得到广泛认可，并广泛应用于知名品牌厂商的终端产品，公司研发的多款产品在半导体领域获得了诸多奖项。

问题五：请介绍公司测试中心、实验室的建设情况。

回答：公司目前已经建成约 6000 平方米的可靠性实验室和测试中心，未来我们还会持续加强实验室和测试中心的建设。自有可靠性实验室相对外包第三方测试能够提供更高更严格的可靠性保障，从而为艾为产品在手机、AIoT、工业、汽车等各大领域打造可靠性及高品质保驾护航。高标准的可靠性验证已成为艾为产品

证券简称：艾为电子

证券代码：688798

	<p>品质保障的标准工作流程。测试中心包括 CP 测试和量产测试，也为公司在产品生产过程中提供了更全面的检测指标，切实为手机、AIOT、工业、汽车等各大领域客户提供优质的品质保障。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明</p>	<p>本次活动，公司严格按照相关规定交流沟通，不存在未公开重大信息泄露等情形。</p>
<p>附件清单（如有）</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2024 年 4 月 18 日</p>